

テクノサイエンス株式会社 <http://www.3snet.com> tsc@3snet.com

本社 〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平 3-6-20-303 TEL.044(272)5658FAX.044(272)5198
事業所 〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台 2-11-1-104 TEL.042(769)1655FAX.042(769)1653

静電接合装置

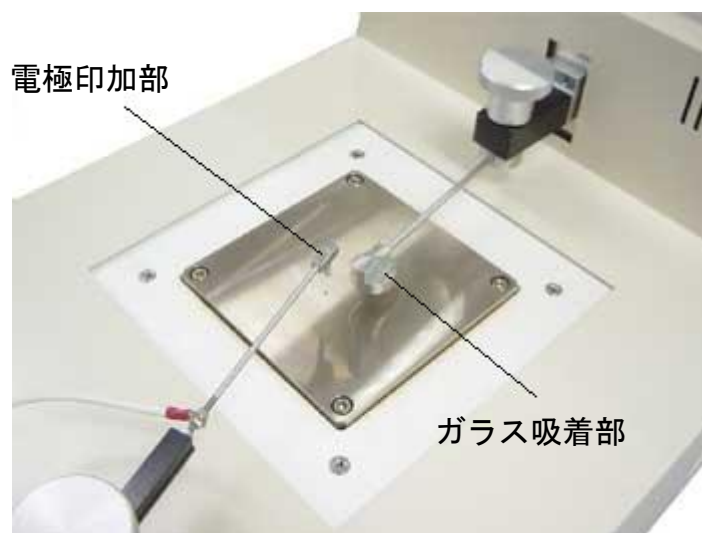
CATNo.10043001

TSC1230

概要 Si 基板とパイレックスガラスを陽極接合方式で張り合わせる装置でさまざまな形状のセンサーやアクチュエータを簡単に試作することができます。

ボイドの少ない強力な化学結合によりセンサー開発・マイクロマシンの開発にご活用下さい

研究、試作用途に適したコンパクトサイズにより低価格でご提供致します。



重ね合わせたシリコン基板とパイレックスガラスが加熱（約 400℃）後、ガラス側に数百 V の負電荷を印加されると、静電引力により界面で化学結合します。

仕様

接合基板サイズ	φ2"（φ51mm）～φ4"（φ100mm）
ヒータ <ul style="list-style-type: none">温度設定範囲温度分布材質	0～450℃（PID 制御方式） ±10℃（φ110mm 以内のヒータ面上） ステンレス（カートリッジヒータ：3 本）
直流電源 <ul style="list-style-type: none">電圧調整範囲	0V～1000V
ガラス吸着 <ul style="list-style-type: none">到達真空度	50Torr
外形寸法	602mm（W）×352mm（D）×272mm（H） （蓋の開き高さ 712mm）
重量	約 29Kg
電源	AC100V、50Hz、20A
価格	¥1,200,000

代理店

 TSC Techno-Science Co., Ltd.

開発・販売元

〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平 3-6-20-303

TEL. 044-272-5658 FAX. 044-272-5198

URL <http://www.3snet.com/>

記載されております内容について、性能向上のためお断り無く 変更する場合がありますので、ご了承下さい。
